附件

湖南省集成电路工程产品

首轮次流片奖励资金

**申**

**请**

**报**

**告**

申 请 单 位： （盖章）

联系人及电话：

通信地址及邮编：

申 请 时 间：

目 录

一、奖励资金申请表

二、申请材料真实性承诺书

三、企业基本情况

四、佐证材料

（请列明具体目录及页码）

1. 集成电路工程产品首轮次流片奖励资金申请表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业全称 | |  | | | | | | |
| 注册地址 | |  | 注册资金 | | |  | | |
| 开户银行 | |  | 账号 | | |  | | |
| 统一社会信用代码 | |  | 纳税人识别号 | | |  | | |
| 企业法人代表 | |  | 联系手机 | | |  | | |
| 奖励申报负责人 | |  | 固定电话 |  | | 联系手机 | |  |
| 在职职工人数（人） | |  | 其中：研发人员 |  | | 研发人员占职工总数比重 | |  |
| 资产总额 | |  | 固定资产总额 |  | | 资产负债率 | |  |
| **企业主要财务指标** | | | | | | | | |
| 年度 | | 营业总收入 | 自主设计产品销售收入 | 研发经费  支出 | | | 上缴税金 | 利润 |
| 2023年 | |  |  |  | | |  |  |
| 2024年 | |  |  |  | | |  |  |
| **芯片项目情况（如申请多个芯片产品奖励，请按产品分别填写）** | | | | | | | | |
| 项目名称 |  | | 项目总投资 |  | | 项目起止时间 | |  |
| 设计工艺 |  | | 应用领域 |  | | 预计年新增  营收 | |  |
| 代工单位名称 |  | | IP授权或购置费 |  | | 掩膜版制作费 | |  |
| 测试化验加工费 |  | | 首轮流片费用  合计（含税） |  | | 申请奖励金额 | |  |
| 市州、县（市、区）主管部门  审核意见 | | 工信部门(盖章)  年 月 日 | | | 财政部门(盖章)  年 月 日 | | | |

二、申请材料真实性承诺书

省工信厅、省财政厅：

我单位承诺：本次申报湖南省集成电路设计产品首轮次工程流片奖励资金所提供的申请材料内容真实准确，提交的申报材料、文件、证照内容真实、可靠、事实存在，复印件与原件一致。企业及企业法人代表无不良信用记录。

申请单位隐瞒有关情况或提供任何虚假材料，愿意承担全部法律责任以及由此产生的一切后果。

特此承诺！

法人代表（签字）: 申请单位（盖章）:

年 月 日

三、企业基本情况

1、企业概况。包括企业资本性质、组织结构、人员构成、发展历程、投资规模、主要业务、行业地位、运营管理模式，所获资质、质量认证、奖项等情况。近两年的年总资产、营收、市场份额、利润及缴纳税收等经营情况，成立时间不足两年的提供自成立以来的相关概况。

2、项目情况。包括项目产品研发背景、主要功能、主要工艺及技术指标情况；项目核心研发团队、经费投入情况，知识产权申请和授权情况；项目产品与业界同类性能最优产品的对比分析，芯片产品的主要优势和应用前景、预期效益情况。

3、流片情况。包括项目产品首轮次工程流片承接厂商、流片数量、费用构成情况以及合同执行情况。

四、佐证材料

1、企业营业执照（副本）复印件；

**2、企业经审计的上一年度审计报告和本项目开支专项审计报告（均需须带验证码），以及完税证明或纳税申报表；**

3、企业生产经营场所、开发环境及技术支撑环境等可证明从事集成电路业务的材料，如使用正版EDA工具的合同、机时交费证明或购买发票等复印件；

4、企业与芯片代工厂（或代理公司、公共服务平台等第三方）签订的新产品首轮流片合同（合同费用包括且仅限IP授权或购置费、掩膜版制作费、测试化验加工费，含税，**英文合同/订单须提供中文翻译件）**、流片合同执行相关的财务凭证、付款发票及银行回单等相关材料；

5、**通过代流片企业流片的，需提供代流片企业与芯片制造企业（或全资子公司）的代理关系佐证材料，并提供申报企业与代流片企业的流片合同、付款凭证，银行回单以及代流片企业与芯片制造企业的流片合同（合同所载流片产品型号须一致）；**

**6、如申报产品存在关联交易，则申报单位应如实提供相应说明（包括交易双方（多方）股权结构等关联情况、交易产品价格公允性说明），不得虚报产品价格；**

7、芯片产品第三方检测报告、芯片版图彩印缩略图、产品外观照片、知识产权证书（或受理通知书）、集成电路布图设计登记证书**以及知识产权相关内容与申报产品核心技术的关联性说明等；**

8、企业有关资质、纳税、荣誉等其他证明材料。

9、如项目申请报告、合同名称、集成电路布图设计登记证书等相关材料中存在产品名称不一致的，须提供情况说明材料。